

융복합 기술과 최고의 메커니즘으로 미래를 선도하는 IT부품기업

*Fine*  
**M·Tec**

**EV Battery Components**  
**Foldable Tech**  
**IT Device Hardware**

**THE INVESTOR RELATIONS OF FINE M-TEC 2024**

2024. 1Q

KOSDAQ 441270 FINE M-TEC CO.,LTD. 2024 © All Rights Reserved

# DISCLAIMER

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 프레젠테이션에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 파인엠텍 (이하 "회사")에 의해 작성되었으며  
이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로  
회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은  
"예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 프레젠테이션 실시일 현재를 기준으로 작성된 것으로, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로  
향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가  
될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 투자자의 합리적인 판단에 의하여 이루어져야만 합니다.

# 회사개요 및 연혁

## 회사개요

회사명	주식회사 파인엠텍
대표이사	이 재 규
설립일	2022년 9월 1일 *주식회사 파인테크닉스로부터 인적분할 설립
상장일	2022년 10월 7일
자본금	18,464 백만원
직원수	국내 120명, 해외 1,700명
사업영역	기구부품 제조(폴더블폰 부품, 자동차 부품 등)
본사주소	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 파인엠텍
홈페이지	<a href="https://finemtec.com">https://finemtec.com</a>

\*상기사항은 2024년 3월 31일 기준이며, 별도의 표시가 없는 경우 연결기준입니다.

## 연혁

- 1992 회사설립 ((주)파인디앤씨)
- 1996 삼성전자 LCD총괄(現 삼성디스플레이) 협력사 등록, 벤처기업 인증
- 2000 회사이전 : 경기도 안양 (안양동 203-9,10 / 現 (주)파인테크닉스 제1공장)
- 2001 공장증설 : 경기도 안양 (안양동 203-3 / 現 (주)파인테크닉스 제2공장)
- 2008 모바일 ITхин지부품 개발·양산 (슬라이더블,폴더블)
- 2009 (주)파인테크닉스 인적분할 설립 (경기도 안양) - LED조명 및 IT부품 제조, 코스닥 상장
- 2012 다이캐스팅 공정 구축완료(Al, Mg, Zn)
- 2013 다이캐스팅 양산 개시 (자동차 및 IT부품)
- 2014 베트남 현지법인 "FINE MS VINA" 설립 (베트남 박닌 소재)
- 2018 베트남 현지법인 "FINE MS VINA" 2공장 증축
- 2019 폴더블폰 부품 개발 완료 및 고객사 단독 납품 개시
- 2020 (주)파인테크닉스 본점 신규사옥 이전 (안양시 만안구)
- 2021 베트남 현지법인 "VINA CNS"설립 (베트남 박닌 소재)
- 2022 **인적분할 예비심사 승인 및 증권신고서 효력발생**  
**(분할기일: 9월1일, 존속: LED조명사업(파인테크닉스) / 신설: IT부품사업(파인엠텍)**  
화성사업장 이전 확장 (EV부품 주력생산)
- 2023 "VINA CNS"법인 3공장 착공 (EV부품 및 힌지 사업 확장)  
EV Battery 기구부품 개발·양산

# 계열회사 및 해외법인

**Fine M-TEC** KOSDAQ  
Anyang, Korea

주요사업  
Mobile Components  
Press Molds  
Die-casting 外



■ 소재지 : 경기도 안양시 안양

**Fine Technix** KOSDAQ  
Anyang, Korea

주요사업  
LED 조명



■ 소재지 : 경기도 안양시 안양7동

**Fine DNC** KOSDAQ  
Asan, Korea

주요사업  
Press Molds,  
Display Chassis  
Escape Stairs



■ 소재지 : 충남 아산시 음봉면

**EMB** KONEX  
Anyang, Korea

주요사업  
EV Battery Recycling  
Solar Plants, ESS  
Mobile Accessories



■ 소재지 : 경기도 안양시 안양7동

**Fine MS Vina**  
Bac Ninh, Vietnam



■ 소재지 : 베트남 박닌

**Vina CNS**  
Bac Ninh, Vietnam



■ 소재지 : 베트남 박닌

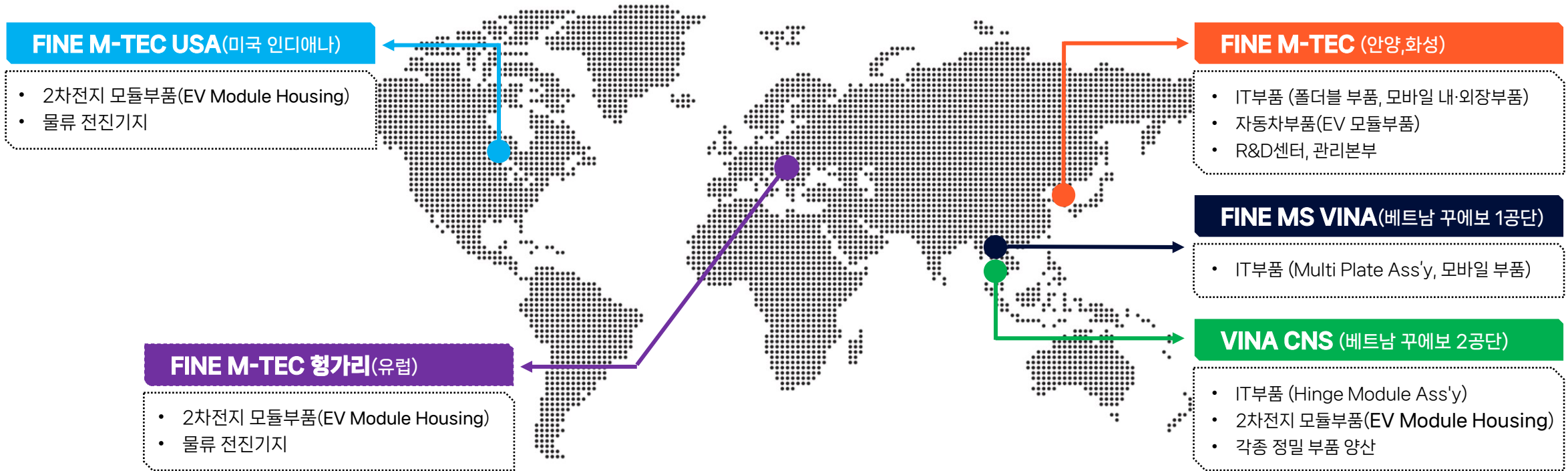
**Fine DNC Slovakia**  
Voderady, Slovakia



■ 소재지 : 슬로바키아

# 글로벌 파인엠텍

국내 R&D의 혁신적 기술개발과 해외 생산기지를 통한 전략적 사업확장



# 주요생산시설 소개 - 베트남 종속법인



MS VINA 전경 (베트남)



\* 3공장 2024년 중순 완공예정

VINA CNS 전경 (베트남)

## MS VINA 시설 소개

- 대지면적 20,000㎡(6,000평)
- Multi Plate Ass'y, 모바일 부품 등 생산
- Etching , Micro Blast , Forming Press , 사출기 등 설비 보유
- Foldable 내장Hinge 자동화 생산/검사(AOI) Line 보유

## VINA CNS 시설 소개

- 대지면적 50,000㎡(15,000평)
- Hinge Module Ass'y, EV Module Housing 등 생산
- 사출기 20대, 다이캐스팅 22대, CNC 106대 등 설비 보유
- EVMH라인 증설 - 3공장 신축 진행

\*(연면적 30,000㎡/9,090평)

파인엠텍의 현재와 미래를 이끌어갈 세 가지 주요 비즈니스 모델을 소개합니다.

폴더블 디바이스, 2차전지 등 정밀기구부품 사업분야 다각화로 사업 포트폴리오 구축

EV Battery Components  
Foldable Tech  
IT Device Hardware

### EV Module Housing

EV시장의 급부상 속에서  
파인엠텍의 차세대 성장동력

01

### Multi Plate Ass'y

독보적 기술력과  
선두주자로서 핵심역량 발휘

02

### Hinge Module Ass'y

탁월한 금속 성형 기술력으로  
폴더블 기구 부품의 최고의 제조 파트너로 도약

03

주요제품소개

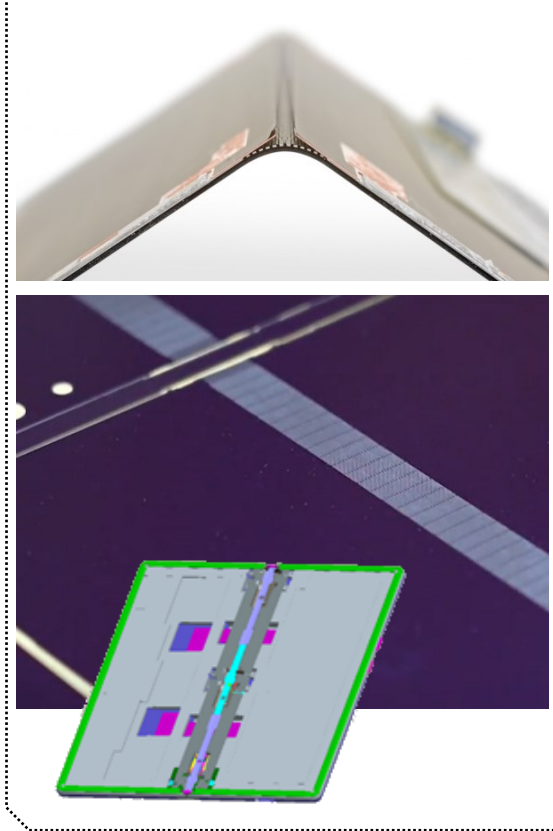
EVMH - End Plate

EV차량 배터리 기구부품 - Cell, Module, Pack 중 Module에 사용



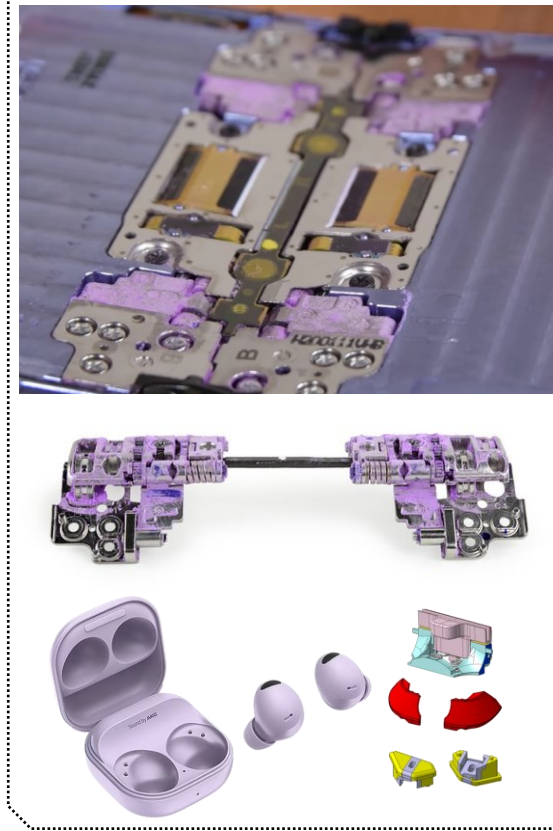
MPA - 내장힌지

폴더블 디스플레이 가이드 플레이트  
SUS, CFRP, GFRP 등 소재다변화



HMA - 외장힌지

폴더블 디바이스 힌지 기구부품  
-폴더블폰, 폴더블 게임기 등 적용 가능



기타부문 - IT 및 차량용 융복합부품

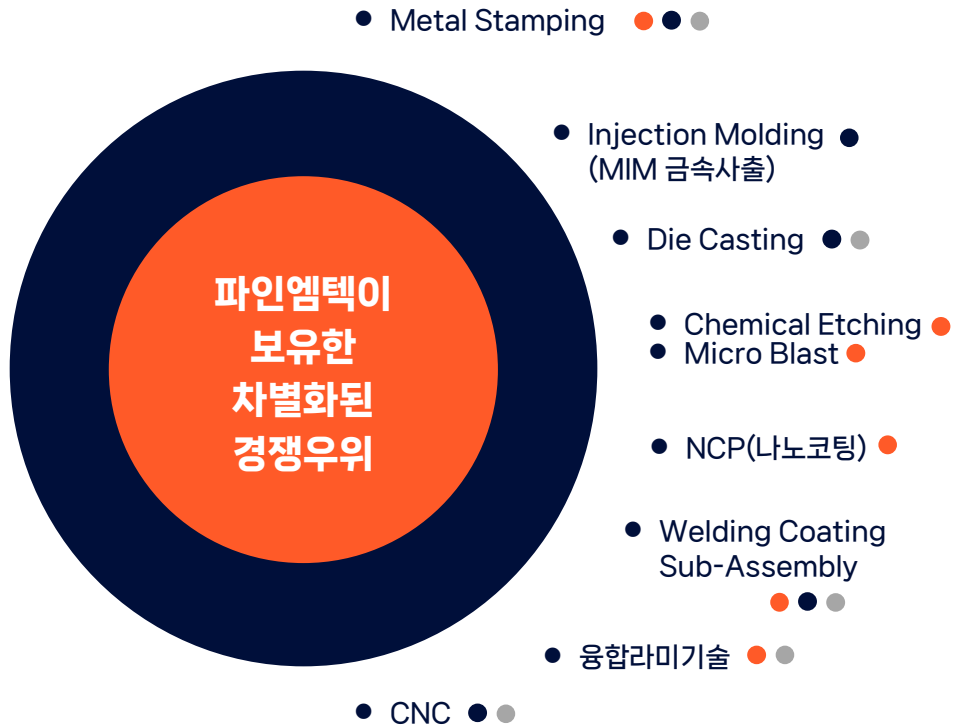
그 외 각종 차량용 기구부품,  
웨어러블 디바이스용 소형정밀 기구부품 등



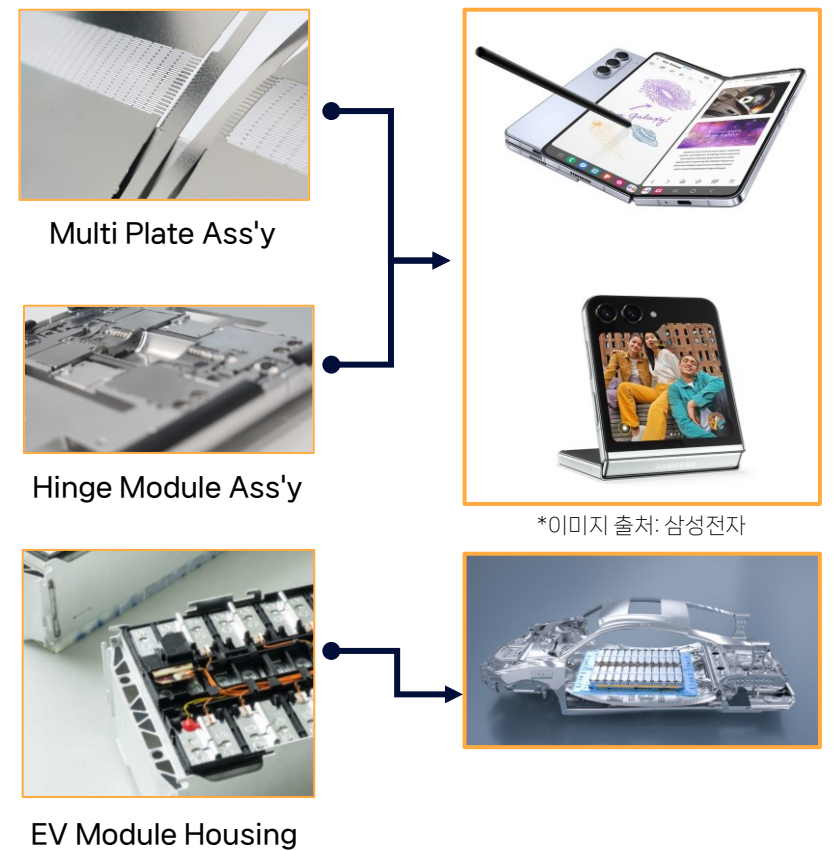


# 보유기술

다양한 기구부품·모듈을 공급할 수 있는 융복합 제조기술 보유

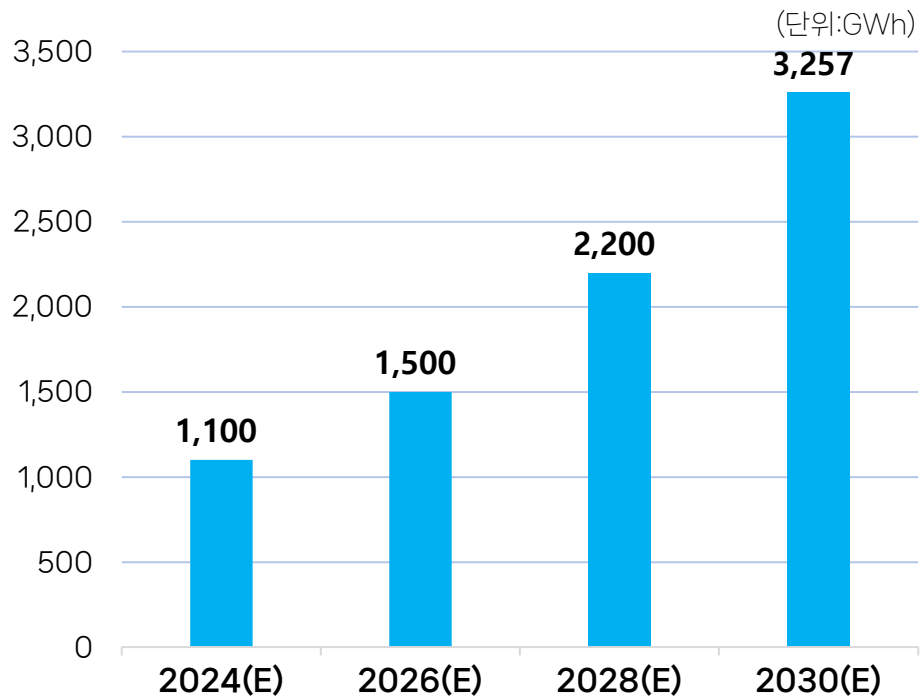


- Multi Plate Ass'y
- Hinge Module Ass'y
- EV Module Housing



# EV Module Housing 사업

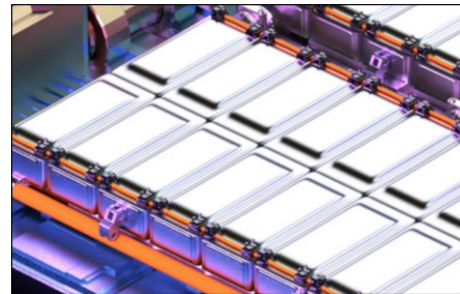
## 글로벌 2차전지 시장전망



- EV 배터리 기구부품인 End Plate를 주력제품으로 파생제품 점차 확대 예정
- 고객사 및 SET사 투자계획에 맞추어 점진적 성장 전망

### 주요제품

- EV Module Housing - 배터리 셀 고정 · 외부로부터의 충격보호, 배터리 스웰링 시 모듈 전체의 외형과 구조 유지
- PDU(Cooling Block) - AC/DC · HV/LV 컨버터 쿨링 모듈



EV Module Housing



Cooling Block & PDU

# Production Facility

• 베트남 VINA CNS – EVMH 라인 신규공장 Setup 진행, '24년 하반기 라인가동 예정

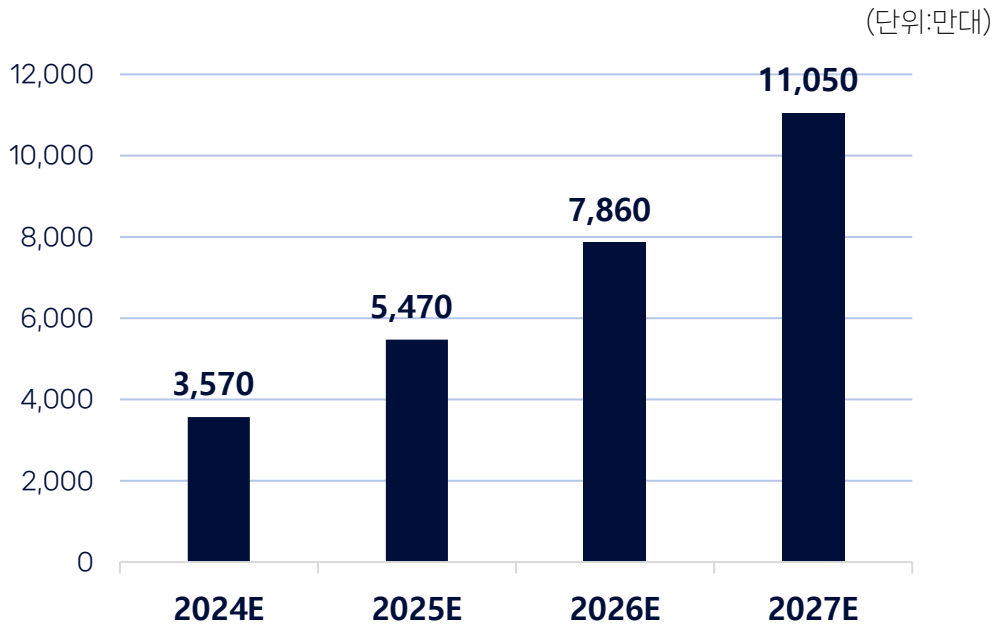


# Multi Plate Ass'y 사업

## 폴더블 스마트폰 시장규모 지속 성장 전망

경쟁사 증가로 인하여 다소 M/S감소 예상되나 시장의 성장세와 함께 **"제품다변화에 따른 지속적인 매출증대 예상"**

### 글로벌 폴더블폰 시장전망



출처: 카운터포인트리서치

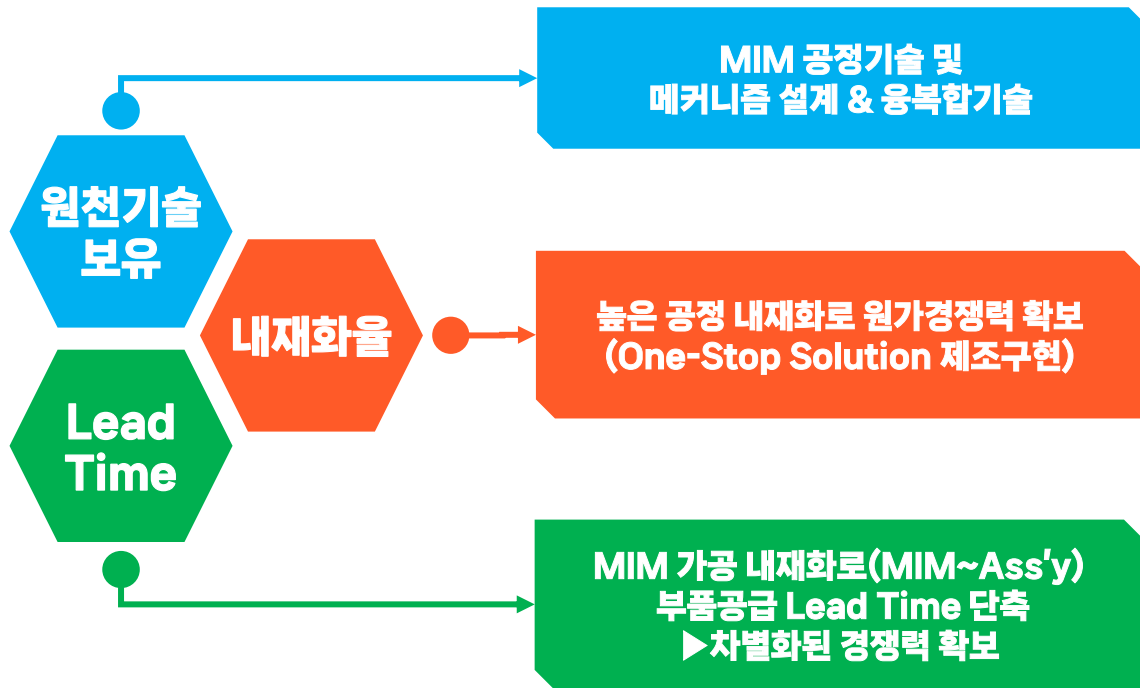
### 주요제품

- **Multi Plate Ass'y** - Flexible Display 구조체 역할 및 보호·방열 기능
- 폴더블폰 대중화, 적용제품 다변화(태블릿, 노트북 등), 세트메이커 증가에 따른 꾸준한 시장 성장 및 확대 전망
- 삼성 폴더블 라인업 점진적 확대 전망
- 경박단소 트렌드에 맞추어 신소재 / 신가공법 지속적 연구개발
  - 신소재 / 신가공법 개발에 지속적 투자
  - 특수소재(Ti, Almag, CFRP, M40 등) 발굴 / 가공 기술 보유

# Hinge Module Ass'y

## 95%이상 내재화된 공정 및 관련기술 보유로 차별화

내재화된 공정으로 고객사 설계변경·납기 등 빠른 대응 가능하며, 국외 정보유출 등 기술보안측면에서도 경쟁력 우위



Multi Plate Ass'y 와 함께 폴더블 기구부품 전방위 진출  
폴더블 기구부품 전문개발·생산업체로 확고한 자리매김 목표

**주요제품**

- Hinge 모듈 - 삼성 갤럭시 폴더블 모델  
뛰어난 내구성과 함께 우수한 폴딩·프리스탑 성능
- '23년 Z-Flip 퀵승인, '24년부터 본격적인 매출증대 기대
- 웨어러블 디바이스부품(хин지) 양산 시작
- 메카니즘 직접 설계 - 다양한 폼팩터에 세일즈 진행중

# 매출 및 영업이익 실적

2024년 주력사업부문인 폴더블 디스플레이힌지(내장힌지)의 매출증대 전망,  
 폴더블 힌지 기구부품(Hinge Module Ass'y) 및 2차전지 기구부품(EV Module Housing)부문 2024년부터 본격 매출 발생 예정

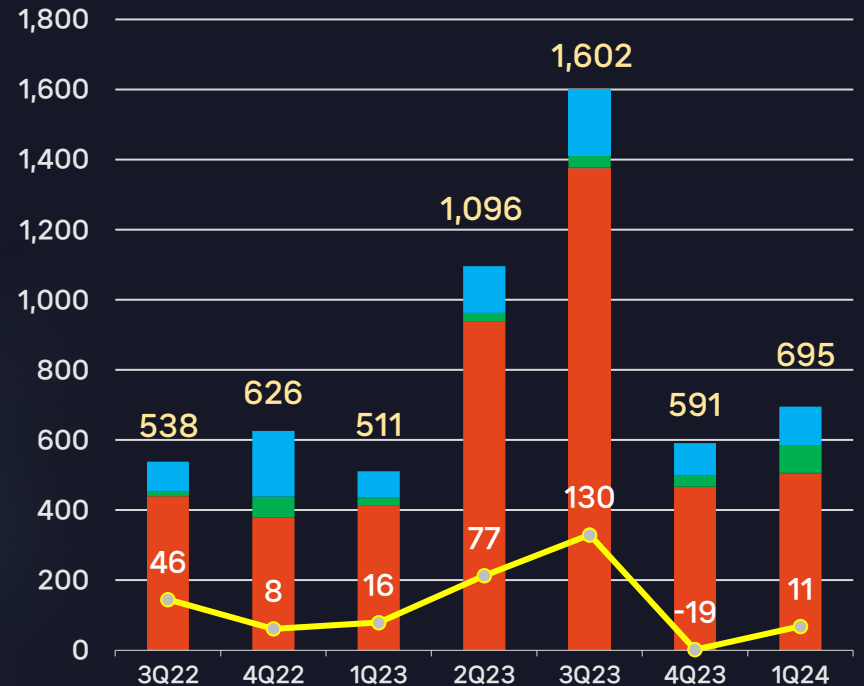


Fine M-Tec

- Multi Plate Ass'y
- Hinge Module Ass'y
- EV Module Housing
- 기타 (모바일 기구부품 등)
- 영업이익

- 폴더블 스마트폰 및 전기차 시장의 급속한 성장 동향에 따른 매출상승 전망
- 태블릿·노트북 등 다양한 폴더블 디바이스 확산 기대

(단위:억원)

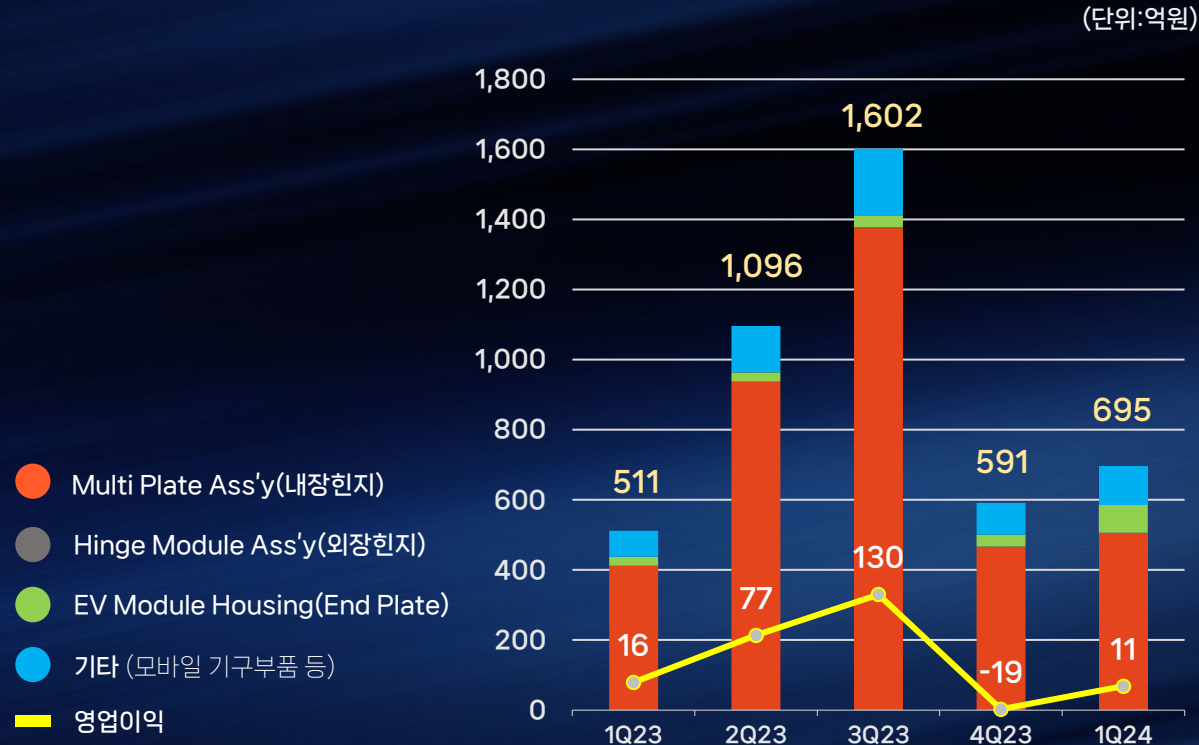


2024년 중화권 폴더블 시장 호조세 전망과 함께 신규사업부문 실적추가로 매출증대 전망

# 매출 및 영업이익 실적

- 1Q24, 전년 동분기 대비 매출액 36% 증가 - MPA부문 중화권 매출 증가 및 EVMH 매출 반영
- 영업이익은 전년 동분기 16억 대비 30%감소한 11억으로 이익률 1.5%p 감소  
- 신규모델 개발비 20억 증가영향, GPM 전년동기대비 1%p 증가

## 분기별실적



## 부문별실적

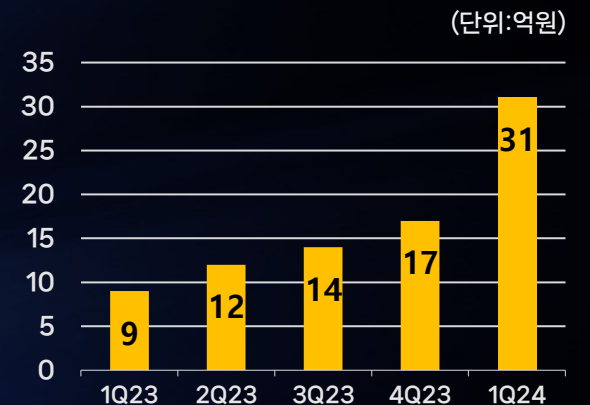
(단위:억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24
Multi Plate Ass'y	504	1,097	1,573	568	3,742	663
Hinge Module Ass'y	-	-	2	1	3	2
EV Module Housing	30	30	39	39	138	105
기타	91	157	220	114	583	146
내부거래차감(-)	114	188	231	131	665	221
<b>계</b>	<b>511</b>	<b>1,096</b>	<b>1,603</b>	<b>591</b>	<b>3,800</b>	<b>695</b>

## R&D 투자내역

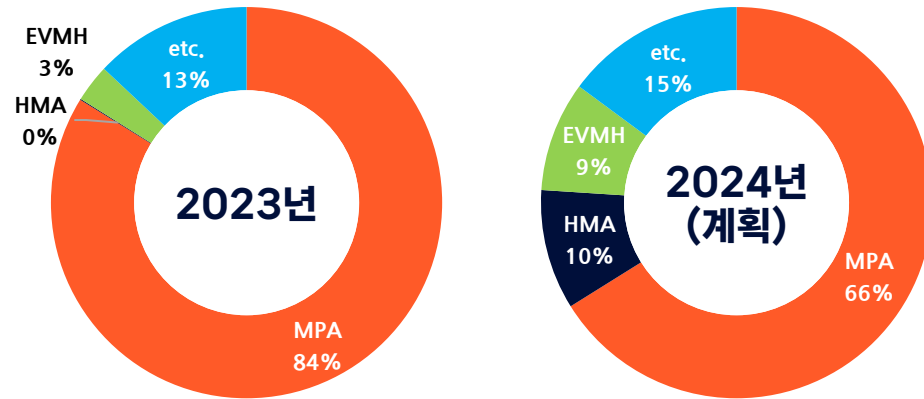
### 경상연구개발비 증가추세

- 고객사 신규모델개발 대응
- 전기누적 53억, 1Q24 31억 250% ↑
- 개발수요 증가에 따른 제품라인업 및 SET사 확대 기대



# 사업부문별 매출비중

.....▶ 기술력 강화 및 사업다각화로 성장과 지속경영 도모



신규 아이템 매출비중 점진적 증가 예상

- Multi Plate Ass'y
- Hinge Module Ass'y
- EV Module Housing
- 기타 (모바일 기구부품 등)

## 사업다각화

신사업 도약으로 매출 다변화 전략(계획)

- Multi Plate Ass'y 2023 84% ▶ 2024E 66%
- Hinge Module Ass'y 2023 0% ▶ 2024E 10%
- EV Module Housing 2023E 3% ▶ 2024E 9%

## 기술력 강화

- 다양한 형태의 폴더블 디바이스 개발역량 강화
- EV Module Housing 기구부품 아이템 확대
- 공정 자동화 설계 역량강화
  - 원가절감 및 수율 향상으로 수익성 증대



융복합 기술과 최고의 메커니즘으로 미래를 선도하는 IT부품기업  
주주가치를 위해 최선을 다하겠습니다.

# THANK YOU

*Fine*  
**M·Tec**

**THE INVESTOR RELATIONS OF FINE M-TEC 2024**

2024. 1Q

KOSDAQ 441270 FINE M-TEC CO.,LTD. 2024 © All Rights Reserved